

中德证券有限责任公司
关于北京君正集成电路股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”“上市公司”“公司”）2020 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“2020 年度非公开发行”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对北京君正 2020 年度非公开发行部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）核准，公司 2020 年度非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。本次募集配套资金（以下简称“募集资金”）采用非公开发行股份方式，发行人民币普通股（A 股）18,181,818 股，发行价格为人民币 82.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,499,999,985.00 元。截至 2020 年 8 月 28 日，公司实际收到募集资金人民币 1,499,999,985.00 元。

上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了[2020]京会兴验字第 01000005 号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至期末累计募集资金投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
支付公司重大资产重组部分现金对价	否	115,949.00	115,949.00	115,949.00	100%	不适用	否
面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目	否	17,900.00	17,900.00	4,350.10	24.30%	2029年01月01日	否
面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目	否	16,151.00	16,151.00	8,568.48	53.05%	2025年06月30日	否
合计	-	150,000.00	150,000.00	128,867.58	-	-	-

三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

本次需要进行延期的 2020 年度非公开发行募集资金投资项目为“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”。

（一）项目基本情况

本项目主要进行新一代高速存储器芯片技术及整体解决方案的研发，由公司下属子公司北京矽成半导体有限公司组织实施，计划募集资金投资金额为 16,151.00 万元。本项目建设期为 5 年，计划完成时间为 2025 年 6 月 30 日。

截至 2025 年 3 月 31 日，“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”累计募集资金投入金额为 8,568.48 万元。

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

车载存储芯片研发项目涉及产品立项、产品定义、设计开发、循环验证等各个环节，同时产业化过程涉及客户的评估、验证和方案设计、车规质量审计、车厂测试等环节，由于车规市场对可靠性、稳定性和安全性的要求比较高，整个过程往往需要较长的时间。

2020年“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”启动以来，全球政治环境、经济形势、市场环境等情况发生较大变化，使得一些研发项目的实施和落地未能如期完成。公司车载存储芯片的研发、验证及推广等工作进度均受到不同程度的影响。同时，2020年至今，汽车市场也经历了较多的需求波动，

自2022年下半年开始，汽车、工业等行业市场景气度持续下降，影响了汽车市场的发展，从而影响了车规市场的产品导入进度。

同时，近几年来，随着汽车智能化的不断发展，汽车市场对存储芯片的数据传输速率、带宽和功耗等性能指标要求不断提高，对存储芯片容量的需求也在不断发展，大容量的存储产品需求不断加大，从而车规存储芯片的工艺制程也需要不断更新迭代。由于车规市场对芯片产品要求的特殊性，工艺制程的更新迭代所需时间通常较长。

“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”设立以来，公司对面向智能汽车领域的高速存储芯片进行了产品定义、设计开发、投片与验证等工作。截至目前，不同类型高速存储芯片中，部分产品已完成样品生产，部分产品研发中，部分产品已处于验证及量产阶段。随着汽车智能化的不断升级，汽车智能驾驶相关技术不断发展，车规市场对存储芯片的需求也在不断增长。公司全资子公司北京矽成在存储器领域耕耘多年，掌握了车规存储芯片的多种相关核心技术，形成了一套完整的技术体系和工程保障体系，能够面向汽车领域提供高品质、高可靠性的各类存储器产品，公司“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”市场可行性和技术可行性均未发生改变。在汽车智能化不断发展的情况下，未来车载存储芯片的市场空间将持续增长，从而给公司存储芯片产品带来更大的成长空间和较好的预期效益。

公司在募投项目实施过程中，需要根据市场发展态势不断调整技术研发和产品规划的进度，以确保募投项目投资的安全稳健。根据车规市场对存储芯片工艺制程的需求趋势，公司启动了基于更先进工艺制程的产品研发。目前公司部分新工艺的存储产品预计可于2025年开始陆续向客户提供样品，公司将持续进行更多产品工艺制程的升级迭代。

鉴于项目实施内容和可行性均未发生改变，考虑到车载存储芯片在设计开发、市场推广、客户产品导入等方面往往需要较长时间，以及项目实施过程中客观因素对实施进度可能造成的影响，公司拟对“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”进行延期，将原计划完成时间由2025年6月30日调整为2030年6月30日。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决

定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

五、相关审议程序及审核意见

2025年4月17日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

六、独立财务顾问专项核查意见

经核查，独立财务顾问认为：北京君正本次部分募投项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形。中德证券对北京君正本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京君正集成电路股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

项目主办人：

姜海强

管仁昊

中德证券有限责任公司

2025 年 4 月 17 日